# 18. Ordentliche Hauptversammlung

20. Mai 2015 – Hotel Pullman Aachen Quellenhof, Aachen



#### **Zukunftsgerichtete Aussagen**

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der 'Safe Harbor'-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten', 'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Präsentation enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Präsentation. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.



# Hauptversammlung 2015 Tagesordnungspunkt 1

# **HV Mai 2015 TOP 1**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
AIXTRON SE zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für das
Geschäftsjahr 2014, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 und des Berichts
des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs



## Redebeitrag zu Tagesordnungspunkt 1

# "Den Wandel konsequent vorantreiben"

**Martin Goetzeler** 

Vorstandsvorsitzender



#### **Erreichte Meilensteine**

- Markteinführung unserer neuen MOCVD Showerheadanlage AIX R6
- Intensivierung der Kundenbetreuung
- Ausbau unserer OLED Aktivitäten
- Verstärkung unserer III/V-Aktivtäten für zukünftige Prozessoren
- Weiterentwicklung unserer ALD-Technologie für Speicherchips
- Fortschritte bei der Leistungselektronik
- Organisatorische Verbesserungen
- Verbesserung der Ertragslage
- 5-Punkte-Programm erfolgreich abgeschlossen

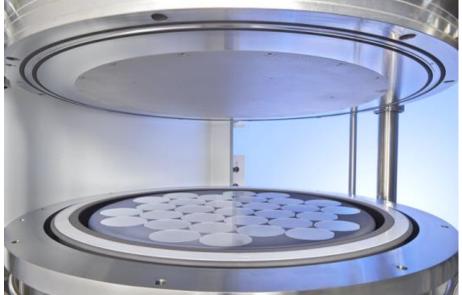


#### **Neue MOCVD Showerheadanlage AIX R6**

#### AIX R6 — Setzt neue Standards bei der LED Herstellung

- Close Coupled Showerhead<sup>®</sup> (CCS)
- Verbesserung der Betriebskosten ggü. dem Vorgängermodell: > 30%
- Kapazitätserhöhung ggü. dem Vorgängermodell: > 60%
- Durchsatzerhöhung ggü. dem Vorgängermodell: >120%





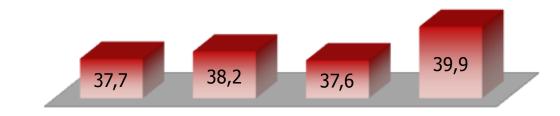




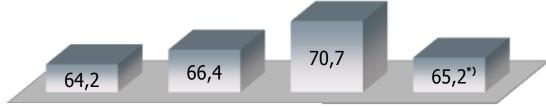
# **Quartalsweise Entwicklung in 2014**

(Millionen €)

Auftragseingang<sup>1)</sup> (nur Anlagen)



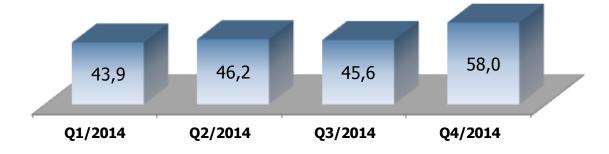
Auftragsbestand<sup>1)</sup> (nur Anlagen)



\*) am 1.1.15 zu 1,25 \$/€ neu bewertet auf €69,0m



Service und Ersatzteilen)



- 1) USD basierte Auftragseingänge und Auftragsbestand wurden zum Budgetkurs umgerechnet (2014: 1,35 USD/€)
- 2) USD basierte Umsatzerlöse wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs der Periode umgerechnet (2014: 1,334 USD/€)



# **Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung\***

(Millionen €)	2014	2013	+/-
Umsatzerlöse	193,8	182,9	6%
Herstellungskosten	152,3	190,3	-20%
Bruttoergebnis	41,5	-7,4	n. m.
Bruttomarge	21%	-4%	25 рр
Vertriebskosten	16,0	29,0	-45%
Allgemeine Verwaltungskosten	19,3	18,2	6%
F&E	66,7	57,2	17%
Sonstige betriebliche (Erträge)/Aufwendungen	-2,2	-16,0	86%
Betriebsergebnis (EBIT)	-58,3	-95,7	39%
EBIT-Marge	-30%	-52%	22 pp
Ergebnis vor Steuern	-57,1	-95,2	40%
Vorsteuermarge	-29%	-52%	23 рр
Nettoergebnis	-62,5	-101,0	38%
Nettoergebnis-Marge	-32%	-55%	23 рр

<sup>\*)</sup> gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich



# **Kennzahlen AIXTRON SE (HGB)\***

(Millionen €)	2014	2013	+/-
Umsatzerlöse	151,6	143,0	6%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50,7	-110,1	54%
Jahresergebnis (nach Steuern)	-52,5	-110,4	53%
Ergebnisvortrag	-1,1	-51,6	98%
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	-161,0	-100%
Bilanzverlust	-53,6	-1,1	n/a
Dividendenvorschlag/Dividende	0,0	0,0	n/a
entspricht Dividende je Aktie (in €)	0,00	0,00	n/a



<sup>\*)</sup> gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

#### **Bilanz AIXTRON Konzern\***

(Millionen €)	31/12/14	31/12/13
Sachanlagen	77,3	79,9
Geschäfts- und Firmenwert	64,8	64,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	2,5	3,1
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4,6	5,7
Langfristige Vermögenswerte	149,2	152,7
Vorräte	81,7	66,2
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	26,3	27,7
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	8,3	10,3
Liquide Mittel/ sonstige Finanzielle Vermögenswerte	268,1	306,3
Kurzfristige Vermögenswerte	384,4	410,5
Eigenkapital	415,7	465,4
Langfristige Schulden	1,3	2,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	16,4	13,5
Erhaltene Anzahlungen	66,9	46,2
Sonstige kurzfristige Schulden	33,2	35,7
kurzfristige Schulden	116,5	95,4
Bilanzsumme	533,5	563,2

<sup>\*)</sup> gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich



# **Kapitalflussrechnung AIXTRON Konzern\***

(Millionen €)	2014	2013	+/-
Mittelzuflüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit	-33,8	8,2	n/a
Mittelzuflüsse/ -abflüsse aus Investitionstätigkeit	-23,2	-39,7	42%
Mittelzuflüsse/ -abflüsse aus Finanzierungstätigkeit	0,2	101,6	-100%
Wechselkursveränderungen	5,9	-2,4	346%
Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente	-50,9	67,7	-175%
Zahlungsmittel und -äquivalente (Periodenbeginn)	167,4	99,7	68%
Zahlungsmittel und -äquivalente (Periodenende)	116,6	167,4	-30%
Veränderung der Festgeldanlagen (Laufzeit >3 Monate)	9,9	30,4	-67%
Free Cashflow**	-47,0	-1,1	n/a



<sup>\*)</sup> gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

<sup>\*\*)</sup> CF lfd. Geschäftstätigkeit + CF Investitionstätigkeit + Veränderung der Festgeldanlagen

# Kennzahlen Q1/2015\*

(Millionen €)	Q1/2015	Q1/2014 <sup>1)</sup>	+/-
Anlagen-Auftragseingang	48,9	49,5	-1%
Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende)	79,0	64,2	23%
Umsatzerlöse	40,3	43,9	-8%
Bruttoergebnis	8,8	10,0	-12%
Betriebsergebnis (EBIT)	-8,8	-10,9	19%
Nettoergebnis	-9,5	-11,8	19%
Zahlungsmittelzufluss (Free Cash Flow)**	-12,1 <sup>2)</sup>	-13,8	12%
Liquide Mittel / Sonstige Finanzielle Vermögenswerte	263,2	292,0	-10%



<sup>1)</sup> Angepasst an neue Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie an neue Ausweisung Gesamtauftragseingang

<sup>2)</sup> Ohne den Effekt i.H. von EUR 1,5 Mio. im Zusammenhang mit der Übernahme der PlasmaSi, Inc.

<sup>\*)</sup> gerundete Zahlen; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

<sup>\*\*)</sup> CF lfd. Geschäftstätigkeit + CF Investitionstätigkeit + Veränderung der Festgeldanlagen

# **Unser Technologieportfolio**

#### Organische **Kohlenstoff-**Verbindungshalbleiter Siliziumhalbleiter **Materialien Strukturen** OVPD® / PVPD® / TFE **MOCVD ALD / MOCVD PECVD** GaN / SiC LEDs, Laser und Graphen, Siliziumhalbleiter **Organische Elektronik Optoelektronik** Leistungshalbleiter **CNTs und CNWs** · LEDs für Displays, TVs, RF Transistoren Dielektrik und Metallelektro • OLEDs für Displays: Transistoren Handys, Tablets, etc. den für DRAM-Speicher Schaltungen AC-DC Umrichter TVs, Handys, Tablets, etc. LEDs für Beleuchtung • Interpoly Dielektrik, Metalle Flexible Elektronik DC-DC Umrichter OLEDs für Beleuchtung für Flash-Speicher • LEDs für Automobile Energiespeicherung · Organische, flexible Solarzellen Gate Stacks für Elektronik • I FDs für • Antriebsmotoren (zur · Sensoren, etc. Organische Photovoltaik Datenkommunikation Anwendung in der Prozessoren ReRAM und PCRAM Industrie, im Auto Dünnfilmverkapselung Laser für und in der Unterhal-Telekommunikation Hochmobile Kanäle für organischer Materialien tungselektronik) Photovoltaik Prozessoren Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagennachfrage erwartet: nachfrage erwartet: nachfrage erwartet: nachfrage erwartet: nachfrage erwartet:

2015

2016/2017



Nach 2018

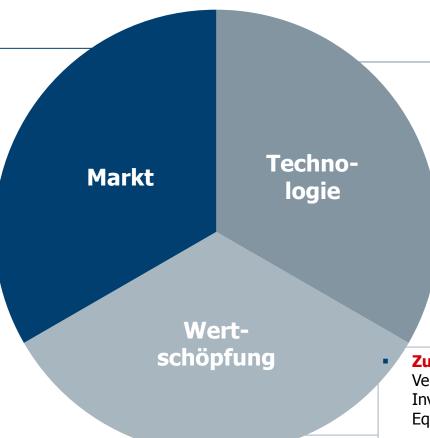
2015

2015/2016

# Akquisition PlasmaSi, Inc.



- Dünnfilmverkapselung:
   Schlüsseltechnologie für großflächige oder flexible Displays sowie OLED-Beleuchtung
- Zugang zu wichtigen Marktteilnehmern
- Zukünftige Marktchancen in sich entwickelnden
   Technologiemärkten: flexible
   Elektronik, organische Photovoltaik,
   Batterietechnologie,
   Hochleistungsbeschichtung von
   Kunststoffen



- Zusätzliche Wertschöpfung: Dünnfilmverkapselung
- Sich ergänzende Produktlinien und Entwicklungsroadmaps
- Stärkung des Kern Know-hows
- Integration der Portfoliotechnologien OVPD, PVPD™, Dünnfilmverkapselung
- Durchbruchpotenzial durch Kombination des eigenen Reaktordesigns mit Prozess Know-how für Schlüsselschichten

- **Zusätzlicher Wertbeitrag**: Beschichtung und Verkapselung machen sind für rd. 60% der Investitionen für OLED Front-end Cell Process Equipment
- Synergien: Integration in AIXTRON Organisation zur Erweiterung des Geschäfts der Dünnfilmbeschichtung



## **Unser Technologieportfolio**

#### Organische **Kohlenstoff-**Verbindungshalbleiter Siliziumhalbleiter **Materialien Strukturen** OVPD® / PVPD® / TFE **MOCVD ALD / MOCVD PECVD** GaN / SiC LEDs, Laser und Graphen, Siliziumhalbleiter **Organische Elektronik Optoelektronik** Leistungshalbleiter **CNTs und CNWs** · LEDs für Displays, TVs, RF Transistoren Dielektrik und Metallelektro • OLEDs für Displays: Transistoren Handys, Tablets, etc. den für DRAM-Speicher Schaltungen AC-DC Umrichter TVs, Handys, Tablets, etc. LEDs für Beleuchtung • Interpoly Dielektrik, Metalle Flexible Elektronik DC-DC Umrichter OLEDs für Beleuchtung für Flash-Speicher • LEDs für Automobile Energiespeicherung · Organische, flexible Solarzellen Gate Stacks für Elektronik • I FDs für • Antriebsmotoren (zur · Sensoren, etc. Organische Photovoltaik Datenkommunikation Anwendung in der Prozessoren ReRAM und PCRAM Industrie, im Auto Dünnfilmverkapselung Laser für und in der Unterhal-Telekommunikation Hochmobile Kanäle für organischer Materialien tungselektronik) Photovoltaik Prozessoren Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-Steigende Anlagen-

nachfrage erwartet:

2015

nachfrage erwartet:

2016/2017



nachfrage erwartet:

Nach 2018

nachfrage erwartet:

2015/2016

nachfrage erwartet:

2015

## **Zusammenfassung und Ausblick**

#### Konsequente Umsetzung und Erreichung der Ziele

- Hauptziele für 2015:
  - Wachstum in allen Technologiebereichen, Umsatzerlöse von 220 250 Mio. Euro
  - Sequenzielle Verbesserung der Ertragslage (H2/15 besser als H1/2015); positives EBITDA in H2/2015
  - Erfolgreiche Qualifizierung und Vermarktung der AIX R6 als Schlüssel
- Entwicklung unserer Zukunftstechnologien zur Marktreife und zeitgerechte
   Einführung in den Markt => 50% des Umsatzes aus Nicht-LED-Geschäft bis 2019
- => Rückkehr in die Profitabilität



# Our technology. YOUR FUTURE.



### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

